

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00981)

海外監管公告

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation,「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於2025年度“提質增效重回報”行動方案的半年度評估報告》，僅供參閱。

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

公司秘書 / 董事會秘書

郭光莉

中國上海，2025年8月28日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

劉訓峰

非執行董事

魯國慶

陳山枝

楊魯閩

黃登山

獨立非執行董事

范仁達

劉明

吳漢明

陳信元

* 僅供識別

中芯国际集成电路制造有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，于 2025 年 3 月 27 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据行动方案的内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年公司行动方案主要举措的落实及进展情况报告如下：

一、聚焦集成电路代工主业，深耕服务全球客户

——抓住产业链在地化转换加速机会，上半年收入同比增长超过两成

公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者。基于国际化运营的理念，为全球客户服务，建立了辐射全球的服务基地与运营网络。

2025年上半年，市场在经历了多重因素的影响下，产业链在地化转换继续走强，更多的晶圆代工需求回流本土，渠道加紧备货、补库存。面对挑战与机遇，公司持续推进产能建设上台阶、绑定客户拓市场、降本增效优运营，各项经营业绩稳中有进、质效向好，保持住了全球第二纯晶圆代工企业的地位。

公司经营业绩稳步提升，上半年实现营收323.5亿元人民币，同比增长23.1%;毛利率21.9%,同比增长8.0个百分点。产能建设方面：二季

度末较2024年底新增近2万片12英寸标准逻辑月产能，工艺研发和平台建设稳步拓展，产品竞争力和市场影响力显著增强。客户合作方面：公司基于客户需求，为其量身定制器件和工艺平台，在供应链在地化替代过程中获得增量订单。降本增效方面：公司上半年产能利用率达到91%，同比增长8个百分点。公司通过提高产能利用率，在增加产出的同时，有效降低了单位销售晶圆的折旧成本，实现了降本增效。

根据国际财务报告准则（IFRS），三季度公司的收入指引是环比增长5%到7%，毛利率指引为18%到20%，与二季度指引相比持平。四季度是行业传统淡季，公司正在广泛收集客户反馈，评估需求情况。在外部环境无重大变化的前提下，公司全年的收入目标依然是超过可比同业的平均值。

二、持续研发创新投入，促进提升新质生产力

——完善产品平台，提供客户完整解决方案

中芯国际拥有全方位一体化的集成电路晶圆代工核心技术体系，能快速有效地帮助客户实现新产品的导入验证到稳定量产。中芯国际成功开发了8英寸和12英寸的多种技术平台，为客户提供“一站式”晶圆代工和技术服务。

2025年上半年，公司研发投入近24亿元人民币，研发投入总额占营业收入比例为7.3%。公司在集成电路领域内积累了众多核心技术，形成了完善的知识产权体系。截至2025年6月30日，公司累计

获得授权专利共 14,215 件，其中发明专利 12,342 件。此外，公司还拥有集成电路布图设计权 94 件。

公司持续推进工艺迭代和产品性能升级，并积极响应客户需求。汽车电子领域，虽然汽车产品的国产替代需要经历两次验证周期，但受益于本土需求增长，公司客户在供应链中的份额持续提升，公司正积极把握这部分增量机遇。分立器件领域，公司的客户、尤其是国外 IDM（垂直整合制造公司）需要公司提供整套解决方案。依托原有 IC（集成电路）管理和产线设备的基础，公司开发相应平台、建立产能并形成规模，现有产能供不应求。

2025 年下半年，公司将继续推进各工艺平台持续研发项目开发工作，完善产品平台，提供客户完整解决方案。

三、不断提升公司治理水平，提高上市公司质量

——**强化内控建设，助力关键少数合规履职**

公司是一家设立于开曼群岛并在香港联交所及上交所科创板两地上市的红筹企业，现行的公司治理制度主要系基于公司注册地和境外上市的相关法律法规及规则制定。公司一直高度重视公司治理水平的提升和完善，不断强化在内控制度、规范运作等方面的合规管理。

2025 年上半年，在治理规范方面，公司及时分析资本市场新规对公司治理及信息披露的影响，贯彻落实相关法律法规要求，制定了《市值管理制度》，修订了《提名委员会章程》《企业管治政策》等制度及细则，并进一步优化公司治理、信息披露相关制度及工作流程。

在“关键少数”履职方面，公司一方面定期向公司的董事及高管传递两地市场新规与监管案例，并安排香港证券律师对董事进行联交所

企业管治新规培训，保障董高能及时了解资本市场新规动态，协助其合规履职；另一方面及时向大股东提示股份变动规则及监管要求，协助其明确不同股份的披露要求，进一步加强大股东、董高等“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，强化合规意识，切实推动公司高质量发展。

在内控建设方面，公司参照《企业内部控制基本规范》及配套指引等执行了 2024 年度的内控审计，出具了《2024 年度内部控制评价报告》。通过梳理公司各项规章制度，优化内部控制环境，提高内部控制管理水平，对现有制度文件管理机制进行回顾和检视，建立新的管理机制并逐步实施，定期检查制度建设与执行情况，保障企业依法合规经营。

四、加强投资者双向沟通，构建多种沟通渠道

——畅通渠道，积极听取外部意见

2025 年上半年，公司召开了 2 次季度业绩说明会和 1 次年度股东会。季度业绩说明会方面，围绕资本市场高度关注的市场需求、行业周期、关税政策，以及公司的生产、运营、财务等多方位多角度议题，公司管理层进行深入浅出的分享和解读,并积极解答投资者提问。年度股东会方面，公司着力提升股东参会体验，包括：优化基础设施建设，提供现代化的会议场馆，为管理层与股东充分交流创造良好硬件条件；预先在公告中发布预登记二维码，显著减少股东现场登记和入场所需时间，并预收集股东关切的问题，提高会议效率；在股东会后，公司管理层、董事会秘书、投资者关系团队继续与投资人进行了坦诚充分的沟通，细致回应股东提出的各类问题。

公司亦通过公告、上证 e 互动、投资者咨询电话和邮箱、公司官网、企业微信公众号、路演、反路演、调研、券商大会、宣传资料、媒体采访等多渠道与投资者进行互动，广开言路，畅通渠道，及时回应市场关切，并收集投资者意见和反馈，形成报告汇报给管理层。

此外，公司推进执行《市值管理制度》，每日监控公司相应指标变化并明确跟进措施；同时，公司积极引导主要股东关注资本市场动态与投资者诉求，助力增强资本市场内在稳定性。

下半年，公司将继续响应监管要求，持续优化投资者关系管理工作。围绕“价值传递、长期共赢”的核心目标，通过多元化沟通渠道和精细化信息披露增强市场信心，深化与投资者的长期信任，推动公司价值与资本市场表现良性互动。

五、贯彻落实“ESG”理念，实现公司可持续发展

——健全绿色低碳发展机制，提升 ESG 管治能力水平

公司坚持完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，将 ESG 作为公司战略落地的重要抓手，完善 ESG 管理体系，坚守可持续发展承诺。公司坚定走生态优先、节约集约、绿色低碳的高质量发展道路，全力保障员工权益，积极参与社会公益，切实提升 ESG 管治能力，各项工作“稳”中向好，“进”中提质。以“双碳”目标为引领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，实现工厂用地高效集约、原料使用无害化处理、生产流程清洁化改造、废弃物资源化利用以及能源低碳转型。

2025 年上半年，公司凭借卓越的 ESG 表现，经中国社会责任报告评级专家委会评定，《中芯国际 2024 年环境、社会及管治（ESG）报告》为“五星级”，荣获《镜报》“杰出企业社会责任奖”等荣誉。

公司持续密切关注两地交易所 ESG 披露指引新规，重点研究气候相关披露要求，开展对标分析，提前规划与制定系统系举措，为 2025 年 ESG 报告的高质量编制与发布奠定了坚实基础。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日